

前田和夫 (マエダ カズオ)

メック株式会社社長



コア技術を生かし「界面創造」を新しい領域へ

◆2005年度3月期第3四半期のポイント

今期第3四半期のポイントとしては、連結売上高が前年同期比で4.1%増加したことが挙げられる。当社の主力製品である薬品の売上は9.2%増となった。一方販売費および一般管理費は前年同期に比べ1億39百万円(7.6%)増加し、結果として営業利益は2.0%減少して8億16百万円となった。海外売上高比率は前年39.7%であったが、今期はアジア、特に中国の伸びによって45%を占めるまでになっている。

◆第3四半期の業績詳細

経理財務センター長 松下太郎

連結の売上高は45億44百万円(前年同期比1億78百万円増)、営業利益は8億16百万円、経常利益は7億98百万円(同54百万円・7.3%増)、純利益は5億24百万円(同69百万円・15.2%増)となった。

単体では売上高33億86百万円(同3百万円減)、営業利益4億7百万円(同90百万円減)、経常利益4億16百万円(同7百万円増)、四半期純利益は2億76百万円(同61百万円増)である。

連結では薬品の売上がアジアで伸びて総額の増加を上回ったが、その分機械その他が減っている。また販売費および一般管理費が粗利益の伸び以上に増加し、メック珠海の立ち上げ費用もあって営業利益では減益となった。単体でも同様の傾向となっている。

経常利益は昨年と逆に為替差益が出ており、特別利益として生命保険返戻金1億円、特別損失で役員退職慰労金64百万円を計上している。

連結貸借対照表を見ると、中間期末時点に比べ総資産額がわずかに増えている。流動資産の比率が若干上がり、固定資産が下がった。負債と資本については、中間期に比べ負債合計の比率が下がり資本合計比率が上がった。

四半期ごとの売上高の動きを見るとオリンピックがあった第2四半期が上がり、第3四半期で少し下がっている。日本単体では第1四半期から少しずつ下がってきているが、これは機械の売上が第1・第2四半期を後押ししていたため、薬品の売上は徐々に上がっている。

連結の営業利益は売上高と同じ動きだが、単体では逆に第1四半期から徐々に上がってきている。これは薬品の売上が伸びたためと、販管費の減少が影響している。

経常利益は営業利益と同じような推移をしているが、為替が第1・第2四半期を押し上げ、第3四半期では押し下げる方向に動いた。純利益は経常利益と同じ動きであった。

連結で品種別の推移を見ると、機械は単価が大きいため売上に対する影響も大きい。設備投資なので波があり、上下している。売上の大部分を占める薬品は順調に増加しており、当第3四半期には14億円台に乗った。

日本単体でも薬品が大部分を占めているが、連結のように徐々に増加する動きはない。これは市場が海外にシフトしているため、その分海外子会社の薬品売上が伸びていると言える。

連結売上高の約90%を占める薬品を、当社では五つのカテゴリーに分けている。中でも主力商品のCZシリーズを含む銅表面処理剤が薬品売上全体の約三分の二に上っており、さらに比率が年々増加している。

単体では銅表面処理剤の比率が連結よりも高く、約70%を超えている状況である。

地域セグメント別では日本が徐々に減ってきており、アジアが伸びている。海外売上高比率もそれに連動して上昇し、昨年第3四半期では40%程度であったものが当第3四半期では47.8%となり、50%に迫っている。

◆ポイント実行により計画は順調

社長 前田和夫

第36期の計画は現在発表している売上高60億46百万円、営業利益10億64百万円、経常利益10億66百万円、当期純利益6億96百万円と変わっておらず、当第3四半期の数字を見ればほぼ計画どおりに進んでいると言えます。

る。

今後の計画ポイント2点は、基本的に変わっていない。1点目である「研究開発への更なる注力」としては、まず単体売上高の約10%を研究開発に投資する。当社の場合、顧客のニーズを取り込みシーズを発信するというマーケティング部分も研究開発部隊が取り込んでおり、中長期的に成長を遂げるためになくはならないと考えている。また高密度用と汎用電子基板の開発を実行するために、一番進んだ領域である高密度用をきちんと押さえて培った技術を水平展開していく。さらに汎用電子基板市場へも比較的付加価値の高いものに対して当社らしいと評価を受ける薬品を提供していき、顧客の生産性向上に貢献することを目指す。

2点目のポイントである「メックグループ販売力の強化」については、日本、中国、台湾、韓国を一つのアジア市場と考えて経営資源を集中していく。また以前より力を注いできたポリイミドベース基板製造用薬品への販売を、更に強力に進める。ポリイミドベース基板の中でも当社が得意としているのは、高精細のパッケージ基板である。現在量産タイプの基板は一番細かいもので35ミクロンピッチが多いが、もっと細くなるのは時間の問題であり、当社製品のチャンスも広がってくると考えている。

日本プリント基板工業会による国内電子基板生産額の推移と予想では、ポリイミドベース基板とモジュール基板が今後も伸び続けるとされており、当社も同様の予測をしている。

世界の電子基板生産額推移では、中国が今後も伸びると予測されている。日本はこのところ伸びておらず、2005年も1%と非常に低い数字となっているが、当社は海外の量を増やし日本では最先端技術をフォローしていこうと考えている。

当社は2001年4月期、第32期に売上のピークを計上しており、今期の予想に至るまでこのピークを超える数字をつけていない。これにはいろいろな要因があるが、例えば機械の売上は当社の製品を売り込むビジネスから、実力ある機械メーカーと協業して全方位的に営業するやり方に変えたため、戦略的に減少している。また昔から販売していた機械の寿命が近づいたり、8~9割のシェアを持っていた製品が少しずつ減少していることも影響している。

当社は新しいコンセプトの商品などにより早く32期のレベルを突き抜け、次のステップへの起爆を迎えたいと現在努力している。

◆「界面創造」を掲げ研究開発を進める

当社は電子基板という非常に限られたカテゴリーの中で、とりわけ銅表面にずっとかかわってきた。現在は研究開発の方向として「界面創造」をコンセプトに掲げている。

物を作るときには必ず異なる物質と物質の境界面があり、界面の信頼性が製品の成否を決めると考えている。信頼性を上げ品質を向上させるために、銅に限らず他の金属や樹脂などにも目を向けていく。場合によっては電子基板という領域も超え、より広い意味での表面処理に当社の技術を生かしていこうと、研究者たちがいろいろな努力をしている最中である。

研究開発の方向性を次の3点にまとめる。

①粗化密着技術から高精細対応へ

今まで最先端のパッケージについては銅表面を粗化密着する技術であったが、今後は粗化にとらわれずさまざまな方法で高精細基板を作る手伝いをしていこうと考えている。

②ポリイミドベース基板用薬品の開発

③汎用多層電子基板用薬品の開発

汎用基板についての前述の考え方により、多層基板の一括積層を行う新コンセプトの黒化処理代替薬品、BOシリーズの拡販を進めていく。

新製品開発のデザイン・レビュー通過状況は、ISOのルールに従ってステップを進めており、DR-0仕様決定レビュー、DR-1仕様確認レビュー、DR-2モニター・実験レビュー段階としている。当第3四半期にはDR-0が1件、DR-1が2件、DR-2が4件上がってきている。

今後の事業展開として、次の3点に注力していきたい。

①事業のコア部分から水平展開

金属表面をコントロールする技術を、電子基板とそれ以外の領域に展開していく。

②基板工程の空白部分を埋める

高精細と一般基板の間部分に注力する。

③ポリイミドベース基板の領域開拓

(平成17年1月26日・東京)